

Presse À Chaud Automatique Sous Vide De 15 Tonnes Avec Plateaux Chauffants De 200X200 Mm Et Refroidissement À Eau

Numéro d'article: XP33



Introduction

Découvrez la presse à chaud automatique sous vide de 15 tonnes de KINTEK : plateaux chauffants de 200x200 mm (jusqu'à 500 °C), contrôle PID précis, refroidissement à eau et chambre en SUS 304 pour le traitement sous vide ou en gaz inerte — parfaite pour les cellules de batterie pouch, le laminage de polymères et le brasage diffusion.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Laminage de cellules de batterie Pouch	Le laminage des cellules pouch pour les batteries lithium-ion ou à état solide nécessite une pression et une chaleur uniformes pour lier les couches sans endommager l'électrolyte. La capacité de vide élimine l'humidité et les gaz, empêchant le délaminage et améliorant la longévité de la cellule.	Élimine le délaminage, améliore la conductivité ionique et prolonge la durée de vie du cycle.
Laminage de films polymères	Laminez des feuilles de polymère ou des films composites pour l'encapsulation électronique, l'emballage médical ou les écrans flexibles sous température et pression contrôlées.	Produit des liaisons sans bulles et à haute clarté avec un contrôle précis de l'épaisseur.
Brasage diffusion	Assemblez des métaux, des alliages ou des céramiques à des températures élevées sous vide élevé sans fusion, créant des liaisons par diffusion atomique.	Atteint des interfaces à haute résistance et sans pores, idéales pour les échangeurs de chaleur et les dispositifs microfluidiques.
Compaction et frittage de poudres	Compressez des poudres métalliques ou céramiques dans une matrice sous vide et chaleur pour former des pastilles denses ou des préformes.	Améliore la densité, réduit la porosité et améliore les propriétés mécaniques et électriques.
Cuisson de matériaux composites	Cuisez des composites renforcés de fibres avancés avec des profils de pression et de température précis dans une atmosphère inerte.	Optimise la réticulation, empêche l'oxydation et assure des laminats sans vides.
Assemblage d'électronique flexible	Laminez et encapsulez des circuits flexibles, des écrans OLED ou des capteurs en couche mince avec des adhésifs activés par la chaleur sous vide.	Maintient l'alignement, élimine les défauts de dégazage et protège les composants sensibles.

Spécification	Valeur / Détails
Modèle	XP33
Pression de travail maximale	≤ 15 Tonnes (150 kN)
Température de travail des plateaux	Température ambiante - 500 °C, écran tactile PID programmable
Puissance de chauffage	3000 W
Dimensions des plateaux	200 mm × 200 mm
Ouverture des plateaux (Hauteur d'ouverture)	50 mm
Pompe à vide incluse	Pompe à vide à palettes rotatives (standard)
Niveau de vide (Relatif)	< -0,1 MPa
Matériau de la chambre	Acier inoxydable SUS 304
Compatibilité des gaz atmosphériques	Azote (N ₂) / Argon (Ar)

Spécification	Valeur / Détails
Méthode de refroidissement	Refroidissement par eau à circulation (les deux plateaux)
Dimensions extérieures	650 × 492 × 725 mm
Poids net	235 kg
Alimentation électrique	CA 220V / 50Hz, Monophasé